3D・チップレット研究会第7回公開研究会

主　催　:システムインテグレーション(SI)実装技術委員会
協賛(予定):日本電子回路工業会(JPCA)、応用物理学会(JSAP)
日本半導体製造装置協会(SEAJ)、SEMIジャパン

◆公開研究会のご案内

研究会テーマ 「3DIC・Chipletに関わる最新実装技術と開発動向」

1つのチップにすべての機能を収納するSoCの時代から、機能ごとにチップを製造し、これらをインテグレーションするチップレット集積の時代への移行が始まっています。チップレット集積には様々な実装構造が議論されており、さらには3DIC(3次元集積化デバイス)も合わせて議論されています。

今回は、3D・チップレット実装に関わる実際の先端技術開発とその動向について各専門家の方々にご紹介頂き、皆様と一緒に技術課題や方向性を考えてみたいと思います。皆様方の積極的なご参加をお待ちしています。

開催日時　2025年6月20日(金)　13:00～17:00(予定)

開催方式　現地開催＆WEBハイブリッド(Zoom Webinarシステム利用)

開催場所:(現地)ナガセグローバル人財開発センター(先着85名様まで:締切 6/12(木))
東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-8-13
(JR代々木駅徒歩約6分・千駄ヶ谷駅徒歩約8分、東京メトロ北参道駅徒歩約3分)

(WEB) Zoom Webinar(先着300名様まで:締切 6/18(水)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します

13:00～13:05
開催にあたって
Rapidus株式会社 専務執行役員　折井 靖光 氏(3D・チップレット研究会主査)

13:05～14:00
①　「我が国の半導体・デジタル産業戦略について」
経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 課長補佐 齋藤 尚史 氏

14:00～14:55
②　「3Dチップレットパッケージに向けたナノポーラスCuめっきを利用したCu-Cu直接接合および大型Si基板技術」
三菱マテリアル株式会社　技術開発室 室長補佐 片瀬 琢磨 氏

(休憩10分)

15:05～16:00
③　「2.5DIC/3DICに向けた革新的な設計環境と設計プロセスの提案」
株式会社 図研　専務執行役員 CTO仮屋 和浩 氏

16:00～16:55
④　「Chiplets and heterogeneous integration: Evolution and Challenges」
Amkor Technology Korea, Inc.　R&D Fellow Mr. WonChul Do

16:55～17:00
終わりに
日本IBM株式会社 東京基礎研究所 部長 堀部 晃啓 氏(SI技術委員会委員長)

17:00～18:00 [現地参加の方]
交流会[1Fフロア]

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください

参加要項

定　　員　　ナガセグローバル人財開発センター:85名(先着申込順　定員になり次第締め切ります)
WEB (Zoom Webinar):　300名(先着申込順　定員になり次第締め切ります)

参 加 費(消費税込み)
正会員:5,000円、 学生会員:無料、 研究会会員:別払い、 シニア会員:2,000円
名誉会員:無料、　賛助会員の社員:5,000円、 賛助会員(クーポン利用):無料
非会員一般:15,000円、 非会員学生:無料、 協賛団体会員:5,000円

[JIEP会員登録](下記URLから会員申し込みが可能です。)
https://jiep.or.jp/admission/adm-guide.html
会員特典
1. 参加費割引(今回公開研究会から会員価格が適用されます。)
2. 学会誌配布(年7回。ただし入会月からの配布)

注意事項(参加方法)

①申込が受理されますと、**返信メールで 公開研究会への参加　URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:クレジットカード決済またはコンビニ決済のみ)(手数料学会負担)
③**領収書(宛名会社名選択可**のご発行は、返信メールのマイページから**決済後に即日出力が可能**です。
④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。

＊キャンセルポリシー：お申込み後のキャンセルはできません。
＊以下についてご注意お願いします。
・講演やセミナー、スピーチなども著作物となります。録画、録音、撮影は著作権侵害に当たります。
・登壇者(話者)に無断で、内容を配信することは公衆送信権の侵害となります。
・非営利目的の配信でも損害賠償責任を負うことがあります。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員　**賛助会員**　**協賛会員**　**非会員**

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先　　一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail:info¥jiep.or.jp(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)